

# 傑出校友 余振華



## 余振華校友小檔案

系級：物理系77B、材料系79G

現職：台灣積體電路製造股份有限公司  
研發副總經理

專長：先進半導體製造技術研發  
先進封測製造技術研發

## 榮譽及傑出成就

余校友在台積電服務的二十餘年期間，領先全球，開發出先進Cu/Low-K，矽中介層(CoWoS)與扇外型整合封裝(InFO)技術，因而得獎無數，包括「傑出科技榮譽獎」(2003年)產業科技發展獎-研發管理創新獎(2005年)、國家十大傑出經理獎(2006年)、台積創新改革暨客戶夥伴獎(2006年)、全國傑出工程師(2009年)及第二屆國家產業創新獎：團體類-年度創新領航獎(2013年)；此外為強化臺灣IC產業競爭優勢及確保技術領先地位，余博士積極投入製程發展相關專利的申請，截至2017年10月已取得700件以上美國專利，其卓越成果於2013年獲得台積電『多產發明獎』的首獎。多數專利皆已應用於先進製程技術生產。余博士獲選為 IEEE Fellow (2013)。

余校友於2017年10月獲得總統科學獎(應用科學組)殊榮。

## 與母校的合作互動

推動多項產學合作，既能推動尖端科技研究，協助提升母校學術地位與台積電技術水準，亦能擴展學弟妹們的視野，增加優質工作機會。

與清大化工鄭西顯教授、清大化工汪上曉教授、清大統計曾勝滄教授合作開發「虛擬晶圓接受測試」及「直通矽穿孔虛擬終止點」等技術。

- 化工系萬其超教授，「無電極電鍍鈷技術應用於保護封套層之研究」。
- 材料系吳泰伯教授，合作開發「電晶體元件高介電材料」。
- 材料系陳力俊教授，合作開發「銅鍍表面鈍化防與護層製作」。
- 動機系江國寧教授，合作開發「電子封裝可靠性加速測試方法」。
- 工程與系統科學系曾繁根教授，合作開發「顯微蒸汽腔室陣列以增進晶片散熱」。
- 2016年獲選第15屆理學院傑出校友。
- 2017年加入清華百人會。
- 2017年12月加入材料系雙百會。